

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本檔全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION**

**中芯國際集成電路製造有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0981)

**中芯國際截至二零一三年三月三十一日止三個月未經審核業績公佈**

- 連續四個季度錄得銷售額新高，二零一三年第一季為伍億零壹佰陸拾萬元，與二零一二年第一季相比增長 50.8%，與二零一二年第四季相比增長 3.2%。
- 二零一三年第一季中國區銷售額佔總銷售額的 38.6%，二零一二年第一季為 32.5%，二零一二年第四季為 34.8%。
- 二零一三年第一季毛利率為 20.4%，二零一二年第一季為 12.0%，二零一二年第四季為 19.9%。
- 二零一三年第一季的中芯國際應佔盈利為肆仟零陸拾萬元，二零一二年第一季的中芯國際應佔虧損為肆仟貳佰捌拾萬元，二零一二年第四季的中芯國際應佔盈利為肆仟陸佰陸拾萬元。

以下為本公司於二零一三年四月二十四日就截至二零一三年三月三十一日止三個月的未經審核業績公佈全文。

所有貨幣以美元列賬，除非特別指明。

本公司自二零一二年起依國際財務報告準則編製年度合併財務報告，此為首次依國際財務報告準則編製季度業績報告，所有前期可比較財務資訊已按照國際財務報告準則之規定予以重分類。

**中國上海 — 2013 年 04 月 24 日 — 國際主要半導體代工製造商中芯國際集成電路製造有限公司(紐約交易所：SMI；香港聯交所：981)(「中芯」或「本公司」)於今日公佈截至二零一三年三月三十一日止三個月的綜合經營業績。**

## 二零一三年第二季指引

以下聲明為前瞻性陳述，此陳述基於目前的期望並涵蓋風險和不確定性，部分已於之後的安全港聲明中闡明。

- 季度收入預期上升在 3%至 5%範圍內。
- 毛利率預期在 20%至 22%範圍內。
- 持續經營業務開支扣除匯兌損益與研發補貼影響後，預期將介於 85 百萬元至 88 百萬元之間。

首席執行官兼執行董事邱慈雲博士評論說：“我很高興向各位報告，中芯國際在二零一三年第一季度銷售額繼續創新高，達到 5 億零 1 百 60 萬元，比二零一二年第一季度增長 50.8%。此外，二零一三年第一季度我們來自中國客戶的銷售額比二零一二年第四季度增長了 14.5%，比二零一二年第一季度增長了 79.1%，來自中國客戶的銷售額約占公司第一季銷售額的 38.6%，再創新高。二零一三年第一季度中芯國際應占盈利為 4 千零 60 萬元，相對二零一二年第一季度應占虧損為 4 千 2 百 80 萬元。即使面臨行業第四季度及第一季度的周期性季節衰退，中芯國際仍然取得了連續五個季度銷售額增長的業績，並且連續四個季度盈利。”

“在第一季，我們 40/45 納米制程貢獻的銷售額比上一季增加一倍以上，對晶圓銷售額的貢獻從二零一二年第四季度的 2.6%上升至二零一三年第一季度的 6.4%。美國及中國市場對移動設備的需求帶動了 40/45 納米制程銷售額的增長。我們 28 納米技術的開發正按計劃進行，HKMG 和 PolySiON 的制程預計在二零一三年第四季度完成。”

“我們預計第二季度收入將持續增長 3%到 5%，達到連續 6 個季度增長。2013 年增長的動力主要來自 40/45 納米制程的產品，我們將鎖定移動設備產品，以及滿足快速增長的中國市場的需求。”

“在此，我需要重申的是，中芯國際將繼續致力於創造持續盈利，成長，以及股東價值。”

---

## 電話會議／網上業績公佈詳情

日期：二零一三年四月二十五日

時間：上海時間上午八時三十分

撥號及登入密碼：

美國 1-718-354-1231（密碼：SMIC）

香港 852-2475-0994（密碼：SMIC）

中國 86-80-0819-0121（密碼：SMIC）

臺灣 886-2-2650-7825（密碼：SMIC）

二零一三年第一季業績公佈網上直播可於以下網址收聽：

[http://www.smics.com/trd/investors/ir\\_presentations.php](http://www.smics.com/trd/investors/ir_presentations.php)，或

<http://www.media-server.com/m/p/se33etcs>。

該直播的錄音版本，連同本新聞稿的電子檔，都在本新聞稿發佈後 12 個月內刊登於 SMIC 的網站上。

---

## 關於中芯國際

中芯國際集成電路製造有限公司（“中芯國際”， 紐交所代號：SMI， 港交所股份代號：981），是世界領先的集成電路晶圓代工企業之一，也是中國內地規模最大、技術最先進的集成電路晶圓代工企業。中芯國際向全球客戶提供 0.35 微米到 40 納米晶圓代工與技術服務。中芯國際總部位於上海，在上海建有一座 300mm 晶圓廠和一座 200mm 超大規模晶圓廠。在北京建有一座 300mm 超大規模晶圓廠，在天津建有一座 200mm 晶圓廠，在深圳正開發一個 200mm 晶圓廠項目。中芯國際還在美國、歐洲、日本和台灣地區提供客戶服務和設立行銷辦事處，同時在香港設立了代表處。

詳細資訊請參考中芯國際網站 [www.smics.com](http://www.smics.com)

---

## 安全港聲明

(根據1995 私人有價證券訴訟改革法案)

本次新聞發佈可能載有(除歷史資料外)依據1995 美國私人有價證券訴訟改革法案的“安全港”條文所界定的「前瞻性陳述」。該等前瞻性陳述，包括“二零一三年第二季指引所述”，及关于预计HKMG和PolySiON的制程在二零一三年第四季完成，和二零一三年第二季銷售額將持續成長3%至5%等聲明乃根據中芯對未來事件的現行假設、期望及預測而作出。中芯使用「相信」、「預期」、「打算」、「估計」、「期望」、「預測」或類似的用語來標識前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性聲明都包含這些用語。這些前瞻性陳述涉及可能導致中芯國際實際表現、財務狀況和經營業績與這些前瞻性陳述所表明的意見產生重大差異的已知和未知風險、不確定性因素和其他因素，以及其他可能導致中芯實際業績、財政狀況或經營結果與前瞻性陳述所載資料存在重大差異的因素，其中包括全球經濟變緩、未決訴訟的頒令或判決，和終端市場的財政穩定等相關風險。

投資者應考慮中芯呈交予美國證券交易委員會(「證交會」)的文檔資料，包括其於二零一三年四月十五日以 20-F 表格形式呈交給證交會的年報，特別是在「合併財務報表」部分，且中芯不時向證交會 (包括以 6-K 表格形式)，或香港交易所(「港交所」)呈交的其他文件。其他未知或不可預測的因素也可能對中芯的未來結果，業績或成就產生重大不利影響。鑒於這些風險，不確定性，假設及因素，本次新聞發佈中討論的前瞻性事件可能不會發生。請閣下審慎不要過分依賴這些前瞻性陳述，因其只於聲明當日有效，如果沒有標明陳述的日期，就截至本新聞發佈之日。除法律有所規定以外，中芯概不負責因為新資料、未來事件或其他原因引起的任何情況，亦不擬更新任何前瞻性陳述。

---

## 二零一三年第一季經營業績概要：

以千美元為單位(每股盈利和百分比除外)

	二零一三年 第一季度	二零一二年 第四季度 <sup>(3)</sup>	二零一二年 季度比較	二零一二年 第一季度	二零一二年 年度比較
收益	501,609	485,894	3.2%	332,711	50.8%
銷售成本	(399,471)	(389,127)	2.7%	(292,867)	36.4%
毛利	102,138	96,767	5.6%	39,844	156.3%
持續經營業務開支	(71,065)	(64,742)	9.8%	(90,127)	-21.2%
其他收入(虧損), 淨額	11,975	17,072	-29.9%	(3,960)	-
除稅前利潤(虧損)	43,048	49,097	-12.3%	(54,243)	-
所得稅利益(開支)	(2,536)	(2,665)	-4.8%	11,418	-
<b>本期利潤(虧損)</b>	<b>40,512</b>	<b>46,432</b>	<b>-12.7%</b>	<b>(42,825)</b>	<b>-</b>
其他綜合收入					
外幣報表折算差異變動	43	(2)	-	44	-2.3%
<b>本期綜合收入(開支)總額</b>	<b>40,555</b>	<b>46,430</b>	<b>-12.7%</b>	<b>(44,781)</b>	<b>-</b>
中芯國際應佔利潤(虧損)	40,604	46,570	-12.8%	(42,825)	-
毛利率	20.4%	19.9%	-	12.0%	-
每股普通股股份盈利(虧損) - 基本和攤薄 <sup>(1)</sup>	0.00	0.00	-	(0.00)	-
每股美國預托股股份盈利(虧損) - 基本和攤薄	0.06	0.07	-	(0.08)	-
付運晶圓(約當 8 吋)	631,776	608,372	3.8%	445,689	41.8%
產能使用率 <sup>(2)</sup>	89.0%	90.5%	-	74.1%	-

附注：

(1) 基於二零一三年第一季加權平均普通股 320 億 1 仟 400 萬股(基本)及 321 億 8 仟 200 萬股(攤薄)，二零一二年第四季 319 億 9 仟 700 萬股(基本)及 320 億 4 仟 400 萬股(攤薄)，二零一二年第一季 275 億零 400 萬股(基本)及 275 億零 400 萬股(攤薄)。

(2) 產能利用率按約當產出晶圓總額除以估計季度產能計算。

(3) 就出售僱員宿舍的應計土地增值稅在第四季業績報告之後，公佈年度合併財務報告之前，有了確定的結果，因此將 2012 年多計提的土地增值稅回轉 6.9 百萬美元，並相應調整第四季度的比較財務數字。

- 二零一三年第一季銷售額由二零一二年第四季的 4 億 8 仟 5 佰 90 萬元上升至 5 億零 1 佰 60 萬元，錄得季度漲幅 3.2%，主要由於 40/45 納米晶圓付運量增加。
- 二零一三年第一季的銷售成本與二零一二年第四季的 3 億 8 仟 9 佰 10 萬元相比上升 2.7% 至 3 億 9 仟 9 佰 50 萬元，主要是由於晶圓的付運量增加。
- 二零一三年第一季的毛利與二零一二年第四季的毛利 9 仟 6 佰 80 萬元相比上升 5.6% 至 1 億零 2 佰 10 萬元。

- 二零一三年第一季的毛利率由二零一二年第四季的 19.9% 上升至 20.4%，主要由於來自武漢新芯的低毛利轉單付運量減少。
- 二零一三年第一季的持續經營業務開支由二零一二年第四季的 6 仟 4 佰 70 萬元上升 9.8% 至 7 仟 1 佰 10 萬元，主要原因請詳持續經營業務開支分析。

## 收入分析

收入分析			
以應用分類	二零一三年 第一季度	二零一二年 第四季度	二零一二年 第一季度
電腦	1.3%	1.0%	3.2%
通訊	47.3%	47.4%	48.3%
消費	42.5%	42.6%	40.2%
其他	8.9%	9.0%	8.3%
以服務分類	二零一三年 第一季度	二零一二年 第四季度	二零一二年 第一季度
晶圓	94.1%	94.0%	94.4%
光罩製造，晶圓測試及其它	5.9%	6.0%	5.6%
以客戶類別分類	二零一三年 第一季度	二零一二年 第四季度	二零一二年 第一季度
無廠房半導體公司	88.7%	86.6%	91.4%
集成裝置製造商	6.1%	9.3%	5.0%
系統公司及其它	5.2%	4.1%	3.6%
以地區分類	二零一三年 第一季度	二零一二年 第四季度	二零一二年 第一季度
北美洲	51.4%	54.4%	55.2%
中國 <sup>(1)</sup>	38.6%	34.8%	32.5%
歐亞 <sup>(2)</sup>	10.0%	10.8%	12.3%
晶圓收入分析			
各技術佔晶圓銷售額的百分比	二零一三年 第一季度	二零一二年 第四季度	二零一二年 第一季度
40/45 納米	6.4%	2.6%	0.3%
55/65 納米	32.1%	35.3%	22.3%
90 納米	6.7%	8.0%	8.6%
0.13 微米	10.7%	10.2%	22.7%
0.15/0.18 微米	39.9%	39.9%	39.4%
0.25/0.35 微米	4.2%	4.0%	6.7%

附註：

(1) 包括香港，不包括臺灣

(2) 不包括中國

## 產能\*

晶圓廠/(晶圓尺寸)	二零一三年 第一季度	二零一二年 第四季度
上海廠(8吋)	90,000	90,000
上海 12吋廠(12吋)	14,150	13,500
北京廠(12吋)	81,000	78,750
天津廠(8吋)	34,450	37,000
每月晶圓代工生產總產能	219,600	219,250

附注：

\*在期末的月產能折算成 8 吋晶圓的片數，且爲了比較目的，以 30 天作爲計算基礎。

- 二零一三年第一季的產能由二零一二年第四季的 21 萬 9 千 250 片 8 吋晶圓增長至 21 萬 9 千 600 片晶圓，主要是由於天津廠的產品組合改變及北京與上海 12 吋廠的生產效率改進。

## 付運及使用率

8 吋等值晶圓	二零一三年 第一季度	二零一二年 第四季度	二零一二年 季度比較	二零一二年 第一季度	二零一二年 年度比較
付運晶圓(包括銅製程)	631,776	608,372	3.8%	445,689	41.8%
使用率 <sup>(1)</sup>	89.0%	90.5%	-	74.1%	-

附注：

(1) 產能使用率按約當產出品圓總額除以估計季度產能計算。

## 詳細財務分析

### 毛利分析

以千美元計	二零一三年 第一季度	二零一二年 第四季度	季度比較	二零一二年 第一季度	年度比較
銷售成本	399,471	389,127	2.7%	292,867	36.4%
折舊	127,339	112,290	13.4%	106,317	19.8%
其他製造成本	271,687	276,367	-1.7%	186,254	45.9%
股權報酬	445	470	-5.3%	296	50.3%
毛利	102,138	96,767	5.6%	39,844	156.3%
毛利率	20.4%	19.9%	-	12.0%	-

- 二零一三年第一季的銷售成本與二零一二年第四季**的 3 億 8 千 9 佰 10 萬元**相比上升**2.7%**至**3 億 9 仟 9 佰 50 萬元**，主要是由於晶圓的付運量增加。
- 二零一三年第一季歸屬於銷售成本的折舊相較於二零一二年第四季增加，主要由於北京廠產能利用率下降。
- 二零一三年第一季的毛利與二零一二年第四季的毛利**9 仟 6 佰 80 萬元**相比上升**5.6%**至**1 億零 2 佰 10 萬元**。
- 二零一三年第一季的毛利率由二零一二年第四季的**19.9%**上升至**20.4%**，主要由於來自武漢新芯的低毛利轉單付運量減少。

### 持續經營業務開支分析

以千美元計	二零一三年 第一季度	二零一二年 第四季度	季度比較	二零一二年 第一季度	年度比較
總持續經營業務開支	71,065	64,742	9.8%	90,127	-21.2%
研究及開發	23,408	26,677	-12.3%	59,311	-60.5%
一般及行政開支	39,783	29,436	35.2%	23,924	66.3%
銷售及市場推廣開支	7,874	8,629	-8.7%	6,892	14.2%

- 二零一三年第一季的研究及開發開支**2 仟 3 佰 40 萬元**，與二零一二年第四季**的 2 仟 6 佰 70 萬元**相比下降**12.3%**，主要由於研究及開發活動使用的晶圓及光罩用量減少所致。
- 二零一三年第一季的一般及行政開支由二零一二年第四季**的 2 仟 9 佰 40 萬元**上升**35.2%**至**3 仟 9 佰 80 萬元**，主要由於計提員工花紅及在二零一二年第四季收回前期壞帳所致。

### 其他收入 (虧損), 淨額

以千美元計	二零一三年 第一季度	二零一二年 第四季度	季度比較	二零一二年 第一季度	年度比較
其他收入 (虧損), 淨額	11,975	17,072	-29.9%	(3,960)	-
財務費用	(10,850)	(10,449)	3.8%	(7,687)	41.1%
利息收入	1,352	1,276	6.0%	1,199	12.8%
其他收入或費用	(1,366)	2,125	-	1,763	-
其他收益或虧損	22,393	24,016	-6.8%	392	5612.5%
應佔聯營公司利潤	446	104	328.8%	373	19.6%

其他收益或虧損大部分是來自處置部分上海生活園區資產所產生的收益。

### 折舊及攤銷

以千美元計	二零一三年 第一季度	二零一二年 第四季度	季度比較	二零一二年 第一季度	年度比較
折舊及攤銷	135,752	140,021	-3.0%	142,888	-5.0%

### 流動資金

以千美元計	二零一三年 第一季度	二零一二年 第四季度
現金及銀行結餘	292,932	358,490
限制性現金	185,031	217,603
其他財務資產	1,239	18,730
貿易及其他應收賬款	355,293	328,211
預付經營開支	51,061	46,986
存貨	284,653	295,728
歸類為持作出售資產	1,428	4,239
流動資產總計	1,171,637	1,269,987
流動稅項負債	60	2,321
其他財務負債	8	25
承兌票據	29,582	29,374
預提負債	73,696	84,611
借貸	529,440	567,803
貿易及其他應付款項	459,235	423,952
流動負債總計	1,092,021	1,108,086
現金比率	0.3x	0.3x
速動比率	0.8x	0.9x
流動比率	1.1x	1.1x

### 資本結構

以千美元計	二零一三年 第一季度	二零一二年 第四季度
現金及現金等價物	292,932	358,490
限制性現金	185,031	217,603
長期票據即期部分	29,582	29,374
短期借款	529,440	567,803
長期借款	429,000	528,612
借款總計	958,440	1,096,415
股本 <sup>(1)</sup>	2,319,036	2,276,452
總債務股本比率 <sup>(2)</sup>	41.3%	48.2%

附注：

(1) 包括非控制權益部分。

(2) 總債務股本比率為借款總計除以股本。借款總計包含短期借款和長期借款。

二零一三年三月三十一日的現金及現金等價物與二零一二年十二月三十一日的 3 億 5 千 8 百 50 萬元相比下降 18.3% 至 2 億 9 千 2 百 90 萬元，主要由於本公司將現金用於償還部分銀行借款。

### 現金流量概要

以千美元計	二零一三年 第一季度	二零一二年 第四季度
經營活動所得現金淨額	154,638	183,799
投資活動所用現金淨額	(82,628)	(74,719)
融資活動（所用）所得現金淨額	(137,503)	17,835
滙率變動的影響	(65)	(210)
現金變動淨額	(65,558)	126,705

### 資本開支概要

- 二零一三年第一季資本開支為 1 億 8 千 4 百 70 萬元。
- 本公司已計畫二零一三年用於晶圓廠運作的資本開支由 7 千 5 百萬元增加至 6 億 7 千 5 百萬元，主要用於擴張上海 12 吋廠產能，以符合消費端對 40/45 納米產能的需求。

## 近期公佈

- 中芯國際捐贈 200 萬元資助肝移植貧困兒童 (2013-04-12)
- 董事會會議日期通知 (2013-04-03)
- 二零一二年年度業績公佈 (2013-03-25)
- 有關與湖北省科技投資集團有限公司成立合資企業之主要交易的進一步資料 (2013-03-25)
- 董事會通過刊發二零一二年年度業績報告日期通知 (2013-03-13)
- 中芯國際 CEO 邱慈雲再次當選 GSA 董事 (2013-03-13)
- 商務長辭任 (2013-02-28)
- 中芯國際截至二零一二年十二月三十一日止三個月未經審核業績公佈 (2013-02-06)
- 中芯國際被列入 Ocean Tomo 300 專利指數 (2013-02-01)
- Kilopass 非易失性記憶體 IP 通過中芯國際先進工藝 JEDEC 認證 (2013-01-31)
- 董事會會議日期通知 (2013-01-09)
- 中芯國際被再次列入恒生可持續發展企業基準指數 (2013-01-07)

上述公佈詳情請參閱中芯國際網站:

[http://www.smics.com/trd/press/press\\_releases.php](http://www.smics.com/trd/press/press_releases.php) 及 [http://smics.com/trd/investors/ir\\_filings.php](http://smics.com/trd/investors/ir_filings.php)

中 芯 國 際 集 成 電 路 製 造 有 限 公 司  
簡明合併綜合收入表

(以千美元為單位，每股資料除外)

	截至以下日期止三個月	
	二零一三年 三月三十一日 (未經審核)	二零一二年 十二月三十一日 (未經審核)
收益	501,609	485,894
銷售成本	(399,471)	(389,127)
毛利	102,138	96,767
研究及開發	(23,408)	(26,676)
一般及行政開支	(39,783)	(29,437)
銷售及市場推廣開支	(7,874)	(8,629)
其他收入，淨額	11,975	17,072
除稅前利潤	43,048	49,097
所得稅開支	(2,536)	(2,665)
<b>本期利潤</b>	<b>40,512</b>	<b>46,432</b>
<b>其他綜合收入</b>		
<i>其後或會重新歸類為損益的項目</i>		
外幣報表折算差異變動	43	(2)
<b>本期綜合收入總額</b>	<b>40,555</b>	<b>46,430</b>
本期以下各方應佔利潤（虧損）：		
本公司擁有人	40,604	46,570
非控制權益	(92)	(138)
	<b>40,512</b>	<b>46,432</b>
本期以下各方應佔其他綜合收入（開支）總額：		
本公司擁有人	40,647	46,568
非控制權益	(92)	(138)
	<b>40,555</b>	<b>46,430</b>
中芯國際應佔每股股份收益，基本及攤薄	0.00	0.00
中芯國際應佔每股美國預托股份收益，基本及攤薄	0.06	0.07
用作計算基本每股普通股收益額的股份	<b>32,014,142,052</b>	<b>31,996,848,100</b>
用作計算攤薄每股普通股收益額的股份	<b>32,182,139,336</b>	<b>32,044,388,752</b>

中芯國際集成電路製造有限公司  
簡明合併財務狀況表  
(以千美元為單位)

	截至以下日期止	
	二零一三年 三月三十一日 (未經審核)	二零一二年 十二月三十一日 (未經審核)
<b>資產</b>		
<i>非流動資產</i>		
物業、廠房及設備	2,443,230	2,385,435
預付土地使用權	73,576	73,962
無形資產	226,787	235,378
於聯營公司的投資	22,190	21,636
遞延稅項資產	43,461	43,380
其他資產	41,065	43,382
非流動總資產	2,850,309	2,803,173
<i>流動資產</i>		
存貨	284,653	295,728
預付經營開支	51,061	46,986
貿易及其他應收款項	355,293	328,211
其他財務資產	1,239	18,730
受限制現金	185,031	217,603
現金及銀行結餘	292,932	358,490
	1,170,209	1,265,748
歸類為持作出售資產	1,428	4,239
流動總資產	1,171,637	1,269,987
<b>總資產</b>	<b>4,021,946</b>	<b>4,073,160</b>
<b>權益及負債</b>		
<i>股本及儲備</i>		
普通股，面值 0.0004 美元，法定股份為 50,000,000,000 股。於二零一三年三月三 十一日及二零一二年十二月三十一日已發 行及流通股份分別為 32,023,168,050 股 及 32,000,139,623 股。	12,809	12,800
股份溢價	4,084,942	4,083,588
儲備	46,857	46,148
累計虧絀	(1,826,432)	(1,867,036)
本公司擁有人應佔權益	2,318,176	2,275,500
非控制權益	860	952
總權益	2,319,036	2,276,452
<i>非流動負債</i>		
借貸	429,000	528,612
遞延稅項負債	314	440
遞延政府補助	171,987	150,347

長期財務負債	4,588	4,223
其他負債	5,000	5,000
非流動總負債	<u>610,889</u>	<u>688,622</u>
流動負債		
貿易及其他應付款項	459,235	423,952
借貸	529,440	567,803
預提負債	73,696	84,611
承兌票據	29,582	29,374
其他財務負債	8	25
流動稅項負債	60	2,321
流動總負債	<u>1,092,021</u>	<u>1,108,086</u>
總負債	<u>1,702,910</u>	<u>1,796,708</u>
<b>權益及負債合計</b>	<b><u>4,021,946</u></b>	<b><u>4,073,160</u></b>

中 芯 國 際 集 成 電 路 製 造 有 限 公 司  
簡明合併現金流量表  
(以千美元為單位)

	截至以下日期止三個月	
	二零一三年 三月三十一日 (未經審核)	二零一二年 十二月三十一日 (未經審核)
<b>經營活動:</b>		
季內利潤	40,512	46,432
折舊及攤銷	135,752	140,021
應佔聯營公司利潤	(446)	(104)
營運資金的變動及其它	(21,180)	(2,550)
<b>經營活動所得現金淨額</b>	<b>154,638</b>	<b>183,799</b>
<b>投資活動:</b>		
對物業、廠房及設備的付款	(123,132)	(97,392)
對無形資產的付款	(14,580)	(17,927)
出售物業、廠房及設備及無形資產所得款項	(8,416)	36,237
與投資活動有關的受限制現金變動	46,388	16,623
收購財務資產付款	(1,527)	(21,617)
出售財務資產所得款項	18,966	9,357
其他	(327)	-
<b>投資活動所用現金淨額</b>	<b>(82,628)</b>	<b>(74,719)</b>
<b>融資活動:</b>		
借款所得款項	55,675	300,229
償還借款	(193,745)	(267,500)
償還承兌票據	-	(15,000)
行使雇員認股權所得款項	567	106
<b>融資活動(所用)所得現金淨額</b>	<b>(137,503)</b>	<b>17,835</b>
匯率變動對以外幣持有現金結餘的影響	(65)	(210)
<b>現金及現金等價物(減少)增加淨額</b>	<b>(65,558)</b>	<b>126,705</b>
<b>現金及銀行結餘－期間開始</b>	<b>358,490</b>	<b>231,785</b>
<b>現金及銀行結餘－期間結束</b>	<b>292,932</b>	<b>358,490</b>

於本公告日期，本公司董事分別為本公司董事長兼執行董事張文義、本公司首席執行官兼執行董事邱慈雲、本公司非執行董事陳山枝、高永崗、劉遵義(及其替任董事陳大同) 及周杰，以及本公司獨立非執行董事川西剛、孟樸及陳立武。

承董事會命  
中芯國際集成電路製造有限公司  
邱慈雲  
首席執行官兼執行董事

中國上海

二零一三年四月二十四日

\* 僅供識別